

## Präsenzseminar Temperaturprofilierung - Messmethoden und Wege zum optimalen Reflowlötprofil



Die Welt der elektronischen Baugruppen ist so vielfältig und komplex, dass es nicht möglich sein wird, alle spezifischen Bedürfnisse der Bauelemente und Materialien hinreichend abzubilden.

Es bleibt also dem Sachverstand und Geschick des Fertigers überlassen, die optimalen Reflowparameter zu finden. Ausreichende Hinweise, Indizien und Erfahrungen sind jedoch vorhanden, um eine Optimierung zu ermöglichen.

Wir laden Sie herzlich zu unserem **Präsenzseminar**

**Temperaturprofilierung** – Messmethoden und Wege zum optimalen Reflowlötprofil

am **10. April 2024** in **Blaubeuren** ein.

Entdecken Sie in unserem Seminar das Machbare vom Mythos zu unterscheiden. Der erste Teil dieses Seminars gibt Ihnen Einblick in die Grundlagen und die optimalen Parameter der Reflowprofilierung. Im zweiten Teil lernen Sie ein Messboard zu präparieren, den Nutzen einer Wärmebildkamera zu verstehen sowie Reflowprofile selbst zu erstellen.

**Teilnehmerzahl:** min. 15 Personen / max. 20 Personen

**Teilnahmegebühr:** 449 € p.P. inkl. Tagungsgetränken, Mittagessen, ausgedruckten Schulungsunterlagen

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie [hier](#).

**Beginn:**

Mittwoch, 10. April 2024, 09:00 Uhr

**Ende:**

Mittwoch, 10. April 2024, 16:30 Uhr

**Veranstaltungsort:**

Online

**Website & Anmeldung:**

Email [s.bartosch@rehm-group.com](mailto:s.bartosch@rehm-group.com)

<https://www.rehm-group.com/aktuelles/termine/detail/presenzseminar-temperaturprofilierung-messmethoden-und-wege-zum-optimalen-reflowloetprofil.html>